

证券代码：002008

证券简称：大族激光

大族激光科技产业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）	
参与单位名称及人员姓名	中金公司（12月5日） PAG（12月8日） 彬元资本（12月9日） 嘉实基金（12月11日） 华商基金（12月11日） 法国巴黎银行（12月12日） 高盛证券（12月15日）	常春藤资产（12月16日） 国海证券（12月18日） 招商证券（12月19日） Point 72（12月19日） 东北证券（12月25日） 平安资管（12月25日） 天风证券（1月5日）
时间	2025年12月5日~2026年1月5日	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	管理与决策委员会副主任、董事会秘书 杜永刚 证券事务代表 王琳	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司经营情况</p> <p>今年以来，随着下游行业需求的逐渐恢复，公司经营情况逐步改善。2025年前三季度实现营业收入1,271,282.29万元，营业利润102,821.90万元，归属于母公司的净利润86,337.71万元，扣除非经常性损益后净利润56,839.55万元，分别较上年同期增减25.51%、-29.72%、-39.46%、51.46%。净利润下降主要由于上年同期公司处置持有的大族思特股权，对归属于上市公司股东的净利润影响约8.90亿元；得益于消费类电子市场回暖及叠加AI驱动带来的供应链强劲需求，</p>	

公司信息产业设备市场需求及经营业绩较上年有所增长，故扣除非经常性损益后的净利润随之增长。

二、公司 PCB 行业发展趋势及核心竞争力

公司控股子公司大族数控（股票代码：301200.SZ）2025 年以来，国内外云解决方案提供商持续提升算力中心投入，AI 算力数据中心服务器、交换机、光模块等终端需求延续强劲态势，PCB 产业直接受益，以高多层板及高多层 HDI 板为主的细分市场需求快速攀升，促进下游 PCB 企业投资力度加大。行业知名研究机构 Prismark 预估 2025 年 PCB 产业营收和产量分别成长 15.4% 和 9.1%，其中与 AI 服务器和交换机相关的高多层板及 HDI 板增长最为强劲，2024-2029 年产能复合成长率分别高达 22.1% 和 17.7%。

公司依托创新的自主研发模式，不断提升综合竞争能力。公司以细分市场及应用场景为中心，依托细分场景研究平台、各产品研发平台及专业技术研究平台，链接终端客户及 PCB 龙头企业等上下游产业链开展研发合作，持续挖掘不同细分场景下的 PCB 制程难点与痛点，突破各细分场景现有工艺瓶颈并满足前瞻需求，并通过各细分场景工艺的自我迭代及提升，持续确保公司产品及解决方案的竞争优势，为下游 PCB 行业客户提供各细分市场（场景）一站式最优加工解决方案。同时，公司业务模式创新发展，通过布局 PCB 生产关键工序及多品类产品为客户提供一站式解决方案，实现了应用场景、技术、供应链、设备与材料、产品、工序、客户的多维协同，并创造性地发挥协同优势，放大客户、供应链及产业链伙伴、公司整体价值，不断提升公司产品的技术和客户服务能力，助力下游客户提升综合竞争力，更好的满足不断演进的 PCB 先进制造需求。

三、公司消费电子设备业务情况

2025 年以来，公司消费电子设备业务营业收入同比有所增长，这一增长源于全球消费电子行业正经历“AI 终端爆发+供应链重构”的双重变革，随着 AI PC、AI 手机、AI 眼镜等终端产品的普及，推动激光加工、3D 打印、自动化检测设备向高精度、多功能集成方向迭代。公司深度参与头部客户前沿研发，为其定制激光钎焊机、密封检测系统等设备，满足 AI 硬件散热结构与微型化需求。消费电子供应链产地已经呈现多元化的发展趋势，境外设备需求呈明显上升趋势，公司

紧跟客户步伐，已组建海外生产、研发、销售团队，在东南亚等地承接大客户产能，抢占供应链多元化红利。

四、公司高功率焊接产品介绍

公司凭借从核心器件、整机设备到工艺解决方案的垂直整合能力，精准响应市场对定制化专机的需求。为应对各行业对焊接工艺的差异化要求，公司构建覆盖全场景的智能焊接产品体系，推出包括换热板激光焊接机、三维五轴激光焊接机、高架龙门激光焊接机、移动龙门激光焊接机、地轨正装式焊接机器人、龙门倒装式焊接机器人、激光电弧复合焊及振镜远程焊等多元化解决方案。通过精准对接航空航天、核能、轨道交通、电力、船舶、钢结构、工程机械等重点领域的制造需求，已为众多行业客户提供专业化焊接技术支持，助力其实现提质增效与智能制造升级。

五、通用工业激光加工设备技术创新与研发进展

随着激光切割行业竞争激烈，市场格局日新月异。面对外部复杂环境，公司坚持研发创新，紧密围绕客户及市场需求，不断优化升级产品；坚持爆品打造，实现产品的大规模市场推广与销售放量；同时，严格坚守质量底线，坚持以质量为本。公司自主研发的三维五轴切割头取得突破，首年销售额突破 5,000 万，实现了广泛的国产替代，普遍应用于汽车行业热成型加工领域。公司推出了全球首台 150KW 超高功率切割机，扩大公司在高端领域的市场影响力。与浙江鼎力、东南网架、中国石油、爱玛科技等客户达成合作，在厚板切割效率、坡口特殊加工工艺等关键技术及超高功率激光切割工艺上持续取得进步。另一方面，根据市场需求，加大对中低端市场的覆盖和拓展，高功率激光切割设备整体市占率稳步提升。

六、公司海外布局发展情况

当前，制造业供应链产地已经呈现多元化的发展趋势，东南亚地区设备需求呈明显上升趋势，公司正大力扩充海外研发销售团队人员，紧跟大客户的步伐，抓住供应链多元化带来的市场机会。在 PCB 海外市场方面，由于国际电子终端品牌加速供应链多元化，泰国、越南等东南亚国家 PCB 产业投资项目纷纷投产，预测未来几年的复合成长率将超过中国大陆。随着产业链的重构，美国、欧洲等

	地区为服务当地半导体产业发展，将全新构建当地的供应体系，其 IC 封装基板未来五年的复合增长率分别高达 18.3% 及 40.6%。
附件清单 (如有)	
日期	2026 年 1 月 5 日